

杭州士兰微电子股份有限公司

对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称	厦门士兰集华微电子有限公司（以下简称“士兰集华”）
本公司及全资子公司合计投资金额	151,000 万元
其他投资方合计投资金额	360,000 万元
投资进展情况	士兰集华完成工商变更登记

一、对外投资基本情况

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月 18 日召开的第九届董事会第三次会议和 2025 年 12 月 8 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于签署〈12 英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目之投资合作协议〉的议案》。

公司及全资子公司厦门士兰微电子有限公司（以下简称“厦门士兰微”）与厦门半导体投资集团有限公司（以下简称“厦门半导体”）、厦门新翼科技实业有限公司（以下简称“新翼科技”）于 2025 年 10 月 18 日签署了《12 英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”）。《投资合作协议》获相关权力机关批准后已生效。

2026 年 3 月，公司及厦门士兰微与厦门半导体、新翼科技、厦门海厦联投资合伙企业（有限合伙）、厦门信翼芯成投资合伙企业（有限合伙）、厦门产投鑫华科技投资合伙企业（有限合伙）共同签署了《12 英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目之投资合作补充协议》（以下简称“《投资合作补充协议》”）。

上述对外投资事项具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日、12 月 9 日和 2026 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的相关公告，公告编号：临 2025-047、临 2025-048、

临 2025-053 和临 2026-007)。

二、对外投资进展情况

根据《投资合作协议》及《投资合作补充协议》，项目公司士兰集华已于近日办理完成相应的工商变更登记。截至本公告披露日，士兰集华最新的股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
厦门海厦联投投资合伙企业（有限合伙）	150,000	29.35	货币
厦门信翼芯成投资合伙企业（有限合伙）	105,000	20.55	货币
厦门产投鑫华科技投资合伙企业（有限合伙）	105,000	20.55	货币
杭州士兰微电子股份有限公司	141,000	27.59	货币
厦门士兰微电子有限公司	10,000	1.96	货币
合计	511,000	100.00	-

注：本公司及厦门士兰微已合计完成实缴出资 151,000 万元，相应出资义务已全部完成。

根据士兰集华最新的股权结构，公司对士兰集华的持股比例由 100%降低至 29.55%，公司将不再将其纳入合并报表范围，将按照权益法核算对士兰集华的投资，并按照持股比例 29.55%计算确认投资收益。

后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日